

证券代码：688123

证券简称：聚辰股份

公告编号：2025-038

聚辰半导体股份有限公司

2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的有关规定，现就聚辰半导体股份有限公司（以下简称“公司”）2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及到账时间

根据中国证券监督管理委员会作出的“证监许可[2019]2336号”《关于同意聚辰半导体股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，公司获准向社会公开发行人民币普通股股票30,210,467股，每股面值人民币1.00元，发行价格为33.25元/股，募集资金总额为人民币1,004,498,027.75元，扣除本次发行费用人民币89,310,416.46元后，募集资金净额为人民币915,187,611.29元。

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）于2019年12月18日将扣除保荐承销费后的募集资金合计930,573,648.30元汇入公司募集资金专户，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对前述事项进行了审验，并出具了“信会师报字[2019]第ZA15884号”《验资报告》。

（二）募集资金实际使用金额及当前余额

截至2025年6月30日，公司累计实际使用募集资金739,377,771.78元，募集资金专户余额为122,671.76元，使用闲置募集资金投资结构性存款及银行大额

存单的余额为 135,000,000.00 元。报告期内，公司募集资金专户资金变动情况如下：

项目	金额（元）
2024 年 12 月 31 日募集资金专户余额	3,313,484.06
减：累计使用闲置募集资金现金管理金额	355,000,000.00
加：累计使用闲置募集资金现金管理赎回金额	350,000,000.00
闲置募集资金现金管理收益金额	1,714,916.67
累计收到银行存款利息收入扣除手续费等金额	94,271.03
2025 年 6 月 30 日募集资金专户余额	122,671.76

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度的制定和执行情况

公司根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规建立了完善的募集资金专项存储制度，募集资金全部存放于经董事会批准设立的专项账户集中管理，募集资金专户不得存放非募集资金或用作其它用途，并与保荐人中金公司、存放募集资金的商业银行签订了募集资金专户存储三方监管协议。具体如下：

1、2019 年 12 月 12 日，公司与中国建设银行股份有限公司上海张江分行以及保荐人中金公司共同签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；

2、2019 年 12 月 12 日，公司与上海银行股份有限公司松江支行以及保荐人中金公司共同签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；

3、2019 年 12 月 13 日，公司与中国工商银行股份有限公司上海市浦东开发区支行以及保荐人中金公司共同签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；

4、2019 年 12 月 17 日，公司与盛京银行股份有限公司北京五棵松支行以及保荐人中金公司共同签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；

5、2021 年 11 月 12 日，公司与厦门国际银行股份有限公司北京海淀桥支行以及保荐人中金公司共同签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；

6、2021 年 12 月 15 日，公司注销在盛京银行股份有限公司北京五棵松支行开立的募集资金专项账户，与盛京银行股份有限公司北京五棵松支行、保荐人中金公司签署的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止；

7、2023 年 5 月 16 日，鉴于公司对“以 EEPROM 为主体的非易失性存储器技术开发及产业化项目”予以结项，并将结项后的节余募集资金永久补充流动资金，公司注销在中国建设银行股份有限公司上海张江分行开立的募集资金专项账户，与中国建设银行股份有限公司上海张江分行、保荐人中金公司签署的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止；

8、2023 年 8 月 14 日，鉴于公司对“研发中心建设项目”予以结项，并将结项后的节余募集资金永久补充流动资金，公司注销在上海银行股份有限公司松江支行开立的募集资金专项账户，与上海银行股份有限公司松江支行、保荐人中金公司签署的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止；

9、2024 年 3 月 22 日，鉴于公司对“混合信号类芯片产品技术升级和产业化项目”予以结项，并将结项后的节余募集资金永久补充流动资金，公司注销在中国工商银行股份有限公司上海市浦东开发区支行开立的募集资金专项账户，与中国工商银行股份有限公司上海市浦东开发区支行、保荐人中金公司签署的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。

以上《募集资金专户存储三方监管协议》明确了各方的权利和义务，主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》一致，不存在重大差异。（详见公司分别于 2019 年 12 月 20 日、2021 年 11 月 13 日、2023 年 4 月 29 日以及 2023 年 12 月 29 日披露的《聚辰股份首次公开发行股票科创板上市公告书》、《聚辰股份关于变更部分募集资金专项账户的公告》、《聚辰股份关于首次公开发行部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》）

2025 年半年度，除前述已披露的销户事项外，上述监管协议履行正常。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2025 年 6 月 30 日，公司募集资金专户存储情况如下：

开户银行名称	银行账号	存储方式	金额（元）
厦门国际银行股份有限公司北京 海淀桥支行	8016100000009224	活期存款	122,671.76
合计	/	/	122,671.76

三、本年度募集资金的实际使用情况

公司首次公开发行股票募集资金投资项目（简称“募投项目”）为“以 EEPROM 为主体的非易失性存储器技术开发及产业化项目”、“混合信号类芯片产品技术升级和产业化项目”和“研发中心建设项目”。

报告期内，公司募集资金实际使用情况如下：

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司未使用募集资金，募集资金使用的具体情况详见本报告“三、（八）募集资金使用的其他情况”以及所附“《聚辰半导体股份有限公司 2025 年半年度募集资金使用情况对照表》”。

（二）募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的情况。

（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

为提高募集资金使用效率，增加公司的收益，在不影响募投项目正常进行和保证募集资金安全的前提下，经第三届董事会第四次会议批准，公司使用总金额不超过人民币 15,000.00 万元的超募资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、有保本约定的产品，使用期限不超过 12 个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。公司监事会和保荐人中金公司就本次使用部分超募资金进行现金管理事项发表了明确同意意见。（详见公司于 2025 年 3 月 25 日披露的《聚辰股份关于使用部分超募资金进行现金管理的公告》）

报告期内，公司使用超募资金投资结构性存款及银行大额存单，均有保本约

定，符合安全性高、流动性好的条件，已到期的产品均已如期回款。截至 2025 年 6 月 30 日，公司使用超募资金投资结构性存款及银行大额存单的余额为 13,500.00 万元。具体情况如下：

办理银行	产品名称	投入金额 (万元)	起始日	到期日	产品期限 (天)	期末余额 (万元)	收益 (万元)
厦门国际银行股份有限公司北京海淀桥支行	公司结构性存款产品（挂钩汇率三层区间 A 款）2024200900719 期	11,000.00	2024/07/22	2025/01/17	179	0.00	125.80
厦门国际银行股份有限公司北京海淀桥支行	厦 门 国 际 银 行 2025 年 第 30 期 单 位 大 额 存 单 DECD25011704	11,000.00	2025/01/20	2025/02/20	31	0.00	17.42
厦门国际银行股份有限公司北京海淀桥支行	公司结构性存款产品（挂钩汇率三层区间 A 款）2024555611230 期	2,000.00	2024/12/31	2025/03/26	85	0.00	10.86
厦门国际银行股份有限公司北京海淀桥支行	厦 门 国 际 银 行 2025 年 第 80 期 单 位 大 额 存 单 DECD25021902	11,000.00	2025/02/21	2025/03/21	28	0.00	17.42
厦门国际银行股份有限公司北京海淀桥支行	厦 门 国 际 银 行 2025 年 第 116 期 单 位 大 额 存 单 DECD25040102	13,500.00	2025/04/03	2025/9/30	180	13,500.00	未到期

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

报告期内，公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

公司首次公开发行股票募集资金投资项目之“以 EEPROM 为主体的非易失性存储器技术开发及产业化项目”、“研发中心建设项目”已于 2023 年 3 月达到预定可使用状态，经第二届董事会第十七次会议批准，公司对“以 EEPROM 为主体的非易失性存储器技术开发及产业化项目”以及“研发中心建设项目”予

以结项，并将结项后的节余募集资金（含利息收益）永久补充流动资金，公司独立董事、监事会、保荐人对此发表了明确同意意见。（详见公司于 2023 年 4 月 29 日披露的《聚辰股份关于首次公开发行部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》）

公司首次公开发行股票募集资金投资项目之“混合信号类芯片产品技术升级和产业化项目”已于 2023 年 12 月达到预定可使用状态，经第二届董事会第二十二次会议批准，公司对“混合信号类芯片产品技术升级和产业化项目”予以结项，并将结项后的节余募集资金（含利息收益）永久补充流动资金，公司独立董事、监事会、保荐人对此发表了明确同意意见。（详见公司于 2023 年 12 月 29 日披露的《聚辰股份关于首次公开发行部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》）

（八）募集资金使用的其他情况

2025 年半年度，公司不存在其他需要披露的募集资金使用情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

（一）募集资金投资项目的变更与调整情况

公司募集资金投资项目均已结项，不存在变更与调整的情况。

（二）未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况

公司募集资金投资项目均已结项，不存在未达计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况。

（三）变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

公司募集资金投资项目均已结项，不存在变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

（四）募集资金投资项目对外转让或置换情况

报告期内，公司募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整。

特此公告。

聚辰半导体股份有限公司董事会

2025 年 8 月 23 日

附表：聚辰半导体股份有限公司 2025 年半年度募集资金使用情况对照表

	形成资金节余； 2、在募投项目建设过程中，公司根据募投项目建设进度合理使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、有保本约定的产品，在确保不影响募投项目正常进行和保证募集资金安全的前提下有效提高了募集资金的使用效率，获得了一定的投资收益，同时募集资金存放期间也产生了一定的存款利息收入。
募集资金其他使用情况	2025 年半年度，公司不存在其他需要披露的募集资金使用情况。

注 1：经 2022 年第一次临时股东大会及 2022 年第二次临时股东大会批准，公司对各募投项目的投资金额和内部投资结构做出调整。调整后的“以 EEPROM 为主体的非易失性存储器技术开发及产业化项目”的募集资金承诺投资总额变更为 48,249.94 万元，“混合信号类芯片产品技术升级和产业化项目”的募集资金承诺投资总额变更为 14,184.04 万元。

注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3：募投项目已于 2023 年度结项。